

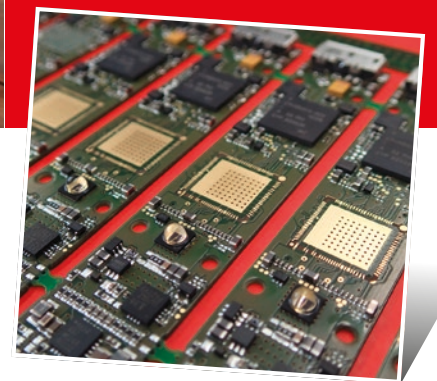
## APPLICATION NOTE

Ausgabe 28

# Drahtgebondeter 3D Chip auf einer ultrakompakten Leiterplatte



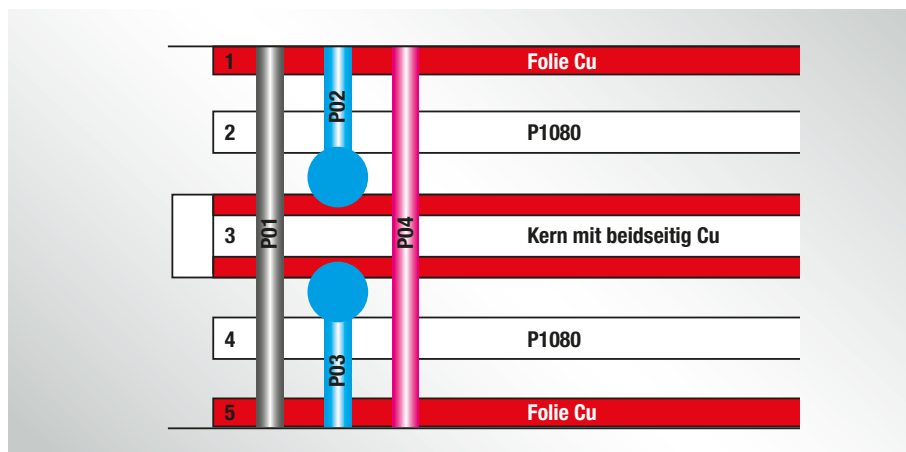
## Gestensteuerung durch 3D Kamerasysteme



Diese HDI Leiterplatte dient als Referenzmodul für 3D Kamerasysteme. Das Modul ermöglicht in diesem Anwendungsbeispiel die Realisierung einer Gestensteuerung.

Die Leiterplatte wird einseitig bestückt und mit der Rückseite in ein Aluminiumgehäuse, welches gleichzeitig als Kühlkörper dient, integriert. Um eine optimale Wärmeableitung sicherzustellen, werden unter den Chip mechanische Thermovias gesetzt.

Zum Schutz der Bonddrähte wird ein Linsenhalter mit der Leiterplatte verklebt.



Lagenaufbau

### Auf einen Blick:

- HDI 1 + 2 + 1 Leiterplatte mit optimalem Wärmemanagement
- Eine auf den Drahtbondprozess abgestimmte SMD Bestückung
- Setzen und Golddrahtbonden des 3D Chips
- Montage des Linsenhalters
- Funktionstest des fertigen Moduls